

# 2020-2026年中国电子材料 行业分析与发展前景报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2020-2026年中国电子材料行业分析与发展前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/174688.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

随着《中国制造2025》、“互联网+”等国家战略的推进实施，智能制造、产业升级又将催生巨大的集成电路市场。这意味着电子封装材料将面临广阔的产业机遇。集成电路正朝着小型化、轻薄化、高性能化、多功能化、高可靠性、成本低的发展趋势发展，而集成电路的封装从原来的二维到更多维的发展。中企顾问网发布的《2020-2026年中国电子材料行业分析与发展前景报告》分析了电子材料行业的产业链，竞争格局，面临的机遇及挑战以及发展前景等，您若想对中国电子材料行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章 电子材料行业相关概述1.1 电子材料相关概述1.1.1 电子材料概念1.1.2 电子材料分类1.1.3 电子材料特性1.2 电子材料产业发展特点1.2.1 寡头垄断特征1.2.2 上下游关联性强1.2.3 技术品种复杂1.2.4 本土化发展趋势1.3 电子材料细分行业介绍1.3.1 半导体材料1.3.2 磁性材料1.3.3 光电子材料1.3.4 电子陶瓷 第二章 2015-2019年中国电子材料行业发展分析2.1 2015-2019年中国电子材料行业发展现状2.1.1 行业发展规模2.1.2 市场竞争格局2.1.3 行业进出口现状2.1.4 行业发展驱动力分析2.1.5 电子材料重要性分析2.1.6 细分市场投资象限分析2.2 2015-2019年国内行业投资动态分析2.2.1 海外并购投资动态2.2.2 本土显示材料投资2.2.3 南京百亿级台资项目2.2.4 内蒙电子新材料投资2.2.5 湖州半导体材料投资2.2.6 宁夏硅材料投资项目2.3 行业发展问题分析2.3.1 对外依存度高2.3.2 产业层次较低2.3.3 高层次人才匮乏2.3.4 融资压力较大2.4 行业发展建议2.4.1 加强政策力度2.4.2 提高国际化水平2.4.3 加强人才培养2.4.4 拓宽融资渠道2.5 中国电子材料行业前景展望2.5.1 电子材料国产化趋势2.5.2 电子材料低碳趋势2.5.3 柔性电子材料发展前景 第三章 2015-2019年半导体材料行业发展分析3.1 半导体材料行业发展综合分析3.1.1 半导体材料发展情况3.1.2 半导体材料实力增强3.1.3 国内市场规模现状3.1.4 材料国产化途径分析3.1.5 有机半导体材料分析3.1.6 半导体化学品综述3.2 2015-2019年半导体硅片材料市场分析3.2.1 国际市场垄断局面3.2.2 大陆产能发展规模3.2.3 国内行业发展瓶颈3.2.4 国内项目投资动态3.2.5 未来市场规模预测3.3 2015-2019年半导体光刻胶市场分析3.3.1 光刻胶相关概述3.3.2 全球市场发展规模3.3.3 中国市场分布格局3.3.4 IC光刻胶市场竞争分析3.3.5 半导体光刻胶发展趋势3.4 2015-2019年半导体抛光材料市场分析3.4.1 CMP抛光材料概述3.4.2 全球市场发展规模3.4.3 国际市场竞争格局3.4.4 国内市场增长迅速3.5 半导体材料行业投资潜力分析3.5.1 国家扶持基金3.5.2 投资空间广阔3.5.3 并购投资机遇3.5.4 投资风险提示3.5.5 投资规模预测 第四章 2015-2019年光电子材料行业发展分析4.1 光电子材料行

业综合分析4.1.1 光电子材料概述4.1.2 光电子晶体材料4.1.3 光导纤维材料4.1.4 OLED材料概述4.1.5 材料发展趋势分析4.2 OLED材料4.2.1 OLED产业链4.2.2 全球市场格局4.2.3 国内供给情况4.2.4 国内竞争格局4.2.5 竞争主体分析4.3 玻璃基板4.3.1 玻璃基板概述4.3.2 产业发展规模4.3.3 外商投资热潮4.3.4 产业突破发展4.3.5 超薄玻璃分析4.4 偏光片4.4.1 偏光片概述4.4.2 偏光片产业链4.4.3 全球市场现状4.4.4 国内市场规模4.4.5 企业投资动态4.5 光导纤维4.5.1 行业发展分析4.5.2 市场运营现状4.5.3 市场发展动态4.5.4 发展前景向好4.6 光纤预制棒4.6.1 光纤预制棒概述4.6.2 国内产业历程4.6.3 行业发展现状4.6.4 项目投资动态 第五章 2015-2019年磁性材料行业发展分析5.1 磁性材料行业综合分析5.1.1 磁性材料产业链5.1.2 行业五力模型分析5.1.3 行业主要壁垒分析5.1.4 软磁材料市场发展5.2 钕铁硼永磁新材料分类概述5.2.1 粘结钕铁硼材料5.2.2 烧结钕铁硼材料5.2.3 热压钕铁硼材料5.2.4 三类钕铁硼对比分析5.3 2015-2019年钕铁硼永磁材料下游市场需求分析5.3.1 音圈电机5.3.2 智能手机5.3.3 变频空调5.3.4 节能电梯5.3.5 传统汽车5.4 2015-2019年国内磁性材料行业竞争主体分析5.4.1 中科三环5.4.2 正海磁材5.4.3 银河磁体5.4.4 宁波韵升5.4.5 安泰科技 第六章 2015-2019年电子陶瓷材料行业发展分析6.1 2015-2019年电子陶瓷行业综合分析6.1.1 电子陶瓷产业链6.1.2 波特五力模型分析6.1.3 全球市场发展规模6.1.4 主要原材料市场格局6.1.5 行业发展机遇与挑战6.2 2015-2019年氧化锆陶瓷材料行业发展情况6.2.1 氧化锆陶瓷优势分析6.2.2 国外龙头企业发展借鉴6.2.3 行业下游市场应用分析6.2.4 氧化锆陶瓷后盖市场预测6.2.5 氧化锆贴片市场前景预测6.3 电子陶瓷其他细分领域发展情况分析6.3.1 高压陶瓷6.3.2 光纤陶瓷插芯6.3.3 燃料电池隔膜板6.3.4 SMD封装基座6.3.5 氧化铝陶瓷基片6.3.6 MLCC电容器6.3.7 微波介质陶瓷6.4 2015-2019年电子陶瓷材料行业竞争主体分析6.4.1 三环集团6.4.2 顺络电子6.4.3 国瓷材料6.4.4 蓝思科技 第七章 2015-2019年其它电子材料发展分析7.1 电子封装材料7.1.1 电子封装材料概述7.1.2 封装材料性能要求7.1.3 传统电子封装材料7.1.4 金属基复合封装材料7.1.5 环氧树脂封装材料7.1.6 电子封装材料发展趋势7.2 覆铜板7.2.1 PCB材料市场背景7.2.2 全球覆铜板市场现状7.2.3 国内行业供给需分析7.2.4 中国外贸市场发展情况7.2.5 “十三五”行业前景展望7.3 超净高纯试剂7.3.1 超净高纯试剂概述7.3.2 全球市场分布格局7.3.3 国内行业产能分析7.3.4 国内市场竞争情况7.3.5 国内行业发展预测7.4 电子气体7.4.1 电子气体概述7.4.2 全球市场规模7.4.3 国内市场格局7.4.4 行业前景向好 第八章 中国电子材料产业投资分析8.1 投资动态8.1.1 本土显示材料投资8.1.2 南京百亿级台资项目8.1.3 内蒙电子新材料投资8.1.4 湖州半导体材料投资8.1.5 宁夏硅材料投资项目8.2 投资机会8.2.1 超薄玻璃8.2.2 柔性材料8.2.3 光学膜材料8.2.4 半导体纳米晶体(量子点) ——8.3 投资风险8.3.1 新产品开发风险8.3.2 人员流动风险8.3.3 项目决策失误风险8.3.4 企业资金链保障的风险

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/174688.html>